

公司代码：688653

公司简称：康希通信



格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

2024 年度，公司实现营业收入 52,278.64 万元，同比增长 25.98%，净利润-7,612.74 万元，同比下降 867.30%。亏损主要是因为公司积极应对全球射频前端行业龙头企业提起的专利诉讼和 337 调查支付的大额律师费，以及高额研发投入等因素导致阶段性亏损。公司处于研发高投入发展阶段，研发投入保持了较高增速，较去年同期增长 71.00%，占营业收入的比重为 20.59%。致使营业收入较上年度大幅增长，但净利润仍出现较大幅度的下滑。

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-7,612.74万元，公司母公司报表中期末未分配利润为1,910.79万元。鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	康希通信	688653	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭雅丽	陈玲
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）
电话	021-50479130	021-50479130
传真	不适用	不适用
电子信箱	kctzqb@kxcomtech.com	kctzqb@kxcomtech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专业的射频前端芯片设计企业，采用 Fabless 经营模式，主要从事 Wi-Fi 射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。

射频前端(RFFE)是广泛应用于手机蜂窝通信(2G/3G/4G/5G)、Wi-Fi 通信、蓝牙通信、ZigBee 通信等无线通信设备中的核心模块之一，主要由功率放大器芯片(PA)、低噪声放大器芯片(LNA)、射频开关芯片(Switch)、滤波器芯片(Filter)等射频前端芯片构成。两种或两种以上芯片裸片合封在同一基板上，构成射频前端模组(FEM)。射频前端芯片及模组主要实现无线电磁波信号的增强放大、优化噪音及过滤干扰信号等功能。

Wi-Fi (Wireless Fidelity) 是一种将电子终端设备以无线方式连接的局域网通讯技术，凭借通信距离远、传输速率快、连接快速等优势，成为无线局域网通信中最普及、应用最广的技术，Wi-Fi 通信成为现代信息化、数字化社会不可缺少的基础要素。

公司主要产品为 Wi-Fi FEM，即应用于 Wi-Fi 通信领域的射频前端芯片模组。由公司自主研

发的 PA、LNA 及 Switch 芯片集成，实现 Wi-Fi 发射链路及接收链路信号的增强放大、低噪声放大等功能。Wi-Fi FEM 的性能对用户使用 Wi-Fi 通信时的联网质量、传输速度、传输距离、设备能耗等具有重要影响。

公司产品广泛应用于家庭无线路由器、家庭智能网关、企业级无线路由器、AP 等无线网络通信设备领域及智能家居、智能蓝牙音箱、智能电表等物联网领域。Wi-Fi 协议标准的升级、频段的增加、MU-MIMO 等多通道技术的采用，推动 Wi-Fi FEM 单颗价值的提升及单设备使用量的增加。万物互联时代的到来，使得 Wi-Fi FEM 市场需求日益增加，其作用也愈来愈重要。

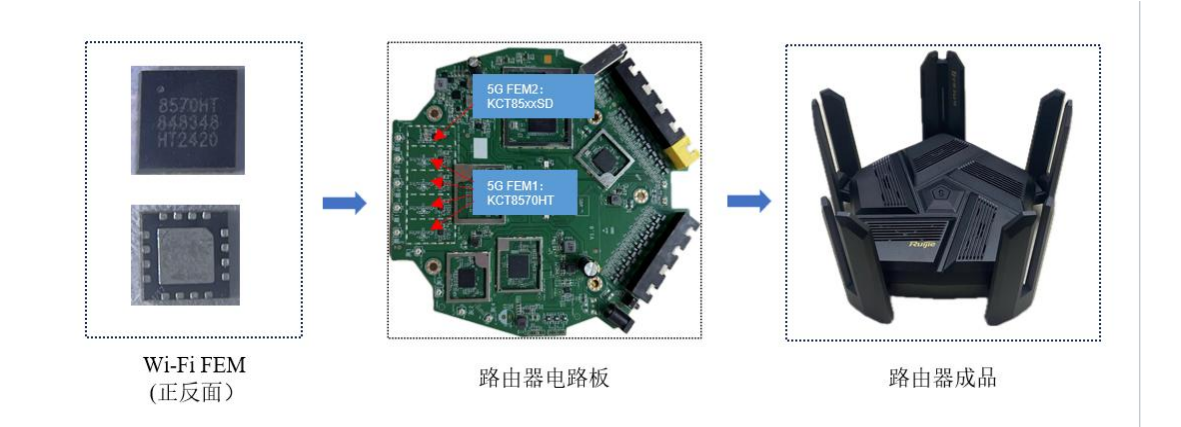
公司致力于研发高性能、高线性度、高可靠性的 Wi-Fi 射频前端芯片及模组，经过多年持续研发投入与技术积累，公司目前已形成 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 等完整 Wi-Fi FEM 产品线组合。公司 Wi-Fi 6 FEM 产品在线性度、工作效率等主要性能指标上，与境外头部厂商的同类产品基本相当，部分中高端型号产品的线性度、工作效率、噪声系数等性能达到行业领先水平。公司多款 Wi-Fi FEM 产品通过博通、高通、联发科、瑞昱等多家国际知名 Wi-Fi 主芯片（SoC）厂商的技术认证，纳入其发布的产品配置方案的参考设计中，体现了公司较强的产品技术实力及行业领先性。公司积极进行 Wi-Fi 7 FEM 技术及产品研发，已有多款产品完成产业化，部分产品完成了与博通、高通、联发科等多家国际知名 Wi-Fi 主芯片（SoC）厂商技术对接以及纳入参考设计的认证工作。2024 年为行业公认的 Wi-Fi 7 元年，公司较早布局 Wi-Fi 7 的设计研发，使得该技术协议产品相关业务在 2024 年开始实现快速增长。公司为提高全球市场占有率，早期便组建了专业的海外业务团队，积极拓展具有发展潜力的海外市场。公司研发的 Wi-Fi 7 产品凭借优异的性能与具有竞争力的价格优势，迅速赢得海外运营商的青睐。公司 Wi-Fi 7 产品通过了博通、高通、联发科等知名 SoC 厂商的参考设计认证，为公司产品突破海外市场奠定了坚实稳固的基础，目前已有数家欧洲、南亚、东南亚等地区运营商及终端客户采购使用了公司产品，为赢得更多海外市场提供了良好的示范效应。截至 2024 年 12 月，公司 Wi-Fi 7 占营业收入比显著提升，获得了 TP-Link、中兴通讯、吉祥腾达、锐捷、小米等客户的青睐。公司管理层根据在手订单等情况预测，2025 年 Wi-Fi 7 的营收占主营业务收入比仍将持续上升，成为 2025 年业绩增长的发力点。

2、主要产品

近年来，得益于下游 Wi-Fi 市场的快速发展及我国芯片国产化进程的加快，公司业绩进入快速增长期。公司已成为国内领先的 Wi-Fi FEM 供应商，也是 Wi-Fi FEM 领域芯片国产化的重要参与者。

公司产品包括 Wi-Fi FEM、IoT FEM、V2X FEM、无人机产品等，集成了公司自主研发的 PA、

LNA 及射频开关等射频前端芯片。



Wi-Fi FEM 的主要工作原理如下：在发射端，数字信号经过主芯片的调制和射频收发器的调频后进入发射链路，通过 PA 对模拟信号的功率进行放大，然后再由天线实现 Wi-Fi 信号发射。在接收端，天线接收到 Wi-Fi 信号后由 LNA 对信号低噪声放大，然后再传导至射频收发器和主芯片，将模拟信号进行解调后转换为数字信号。

Wi-Fi FEM 性能直接影响了用户使用 Wi-Fi 通信时的联网质量、上行及下行传输速度、传输距离、设备能耗等体验。Wi-Fi 是当前移动互联网、物联网时代下最重要的无线通信方式之一，随着万物互联时代的到来，Wi-Fi FEM 的市场需求日益增加，其作用也愈来愈重要。

在物联网领域，智能终端设备一般都会采用 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 等两种或两种以上通信方式，以提高设备联网的便捷性和兼容性，因此，公司也针对物联网（IoT）市场开发了支持蓝牙通信、ZigBee 通信等协议的射频前端芯片模组产品，即 IoT FEM，由公司自主研发的 PA、LNA 及 Switch 射频前端芯片集成，其基本原理及功能与 Wi-Fi FEM 类似。

公司主要产品如下所示：

产品类别	产品系列	产品简介	主要应用领域
Wi-Fi FEM	Wi-Fi 5 系列	公司于 2017 年推出首款支持 Wi-Fi 5 协议的分立式 PA 芯片与全集成 Wi-Fi FEM 产品。采用 GaAs、CMOS 加工工艺、超小封装工艺，产品具备高可靠性、高线性度、高功率、低噪声等特点。	无线路由器、无线 AP、光猫、CPE、机顶盒等
	Wi-Fi 6 系列	公司于 2019 年研发成功并于 2020 年量产支持 Wi-Fi 6 协议的集成 Wi-Fi FEM 产品，采用 GaAs、SOI、CMOS 等工艺，产品具备高集成度、高线性度、高功率、高效率等特点。	无线路由器、无线 AP、光猫、CPE、机顶盒等
	Wi-Fi 6E 系列	公司于 2022 年推出支持 Wi-Fi 6E 协议的集成 FEM 产品，采用 GaAs、CMOS 等工艺，产品具备高集成度、高线性度、高功率、高效率等特点。	无线路由器、无线 AP、光猫、CPE、机顶盒等

	Wi-Fi 7 系列	公司于 2022 年底推出支持 Wi-Fi 7 协议的集成 FEM 产品，采用 GaAs、CMOS 等工艺，产品具备高集成度、高线性度、高功率、高效率等特点。	无线路由器、无线 AP、光猫、CPE、机顶盒等
IoT FEM	-	支持蓝牙协议、ZigBee 协议标准的集成 FEM 产品，采用 CMOS 全集成工艺，产品具备高集成度、低功耗、高性价比等特点。	智能蓝牙音箱、遥控器、智能安防、智能电表、智能家居等物联网产品
IoT FEM	-	利用公司特有的高性价比的 RF CMOS 工艺技术积累，结合砷化镓模拟电路的新技术突破，聚焦低空经济、C-V2X 智能车联网、星闪低功耗蓝牙、智能表计等应用领域，着手研发一系列泛 IoT 射频前端产品，满足各领域客户对高品质无线连接的需求。	低空经济、智能电表、智慧城市、车-路-人-云 互联互通

2.2 主要经营模式

公司是一家专业的射频前端芯片设计企业，主要经营模式为国际集成电路行业通行的 Fabless 模式，即聚焦集成电路研发、生产与销售的无晶圆生产模式。公司集中优势资源用于射频前端芯片及模组的研发、销售环节，生产制造环节则委托独立第三方晶圆制造厂及封装测试厂商代工完成。

公司自主完成集成电路版图的设计后，将设计版图交予晶圆制造厂商，由晶圆制造厂商按照版图生产出晶圆，晶圆交由第三方封装厂商完成芯片与模组的封装环节；封装完成后，再由专业的检测厂商对芯片及模组进行性能检测，测试合格后，方可对外销售。

结合集成电路行业惯例及公司自身经营特点，公司采用直销、经销相结合的销售模式。公司直销客户主要为通信设备品牌厂商或 ODM 厂商，经销客户主要为专业的电子元器件经销商。公司经销模式又分为买断式经销和代理式经销两种模式，买断式经销主要针对境内经销商，代理式经销商主要针对境外经销商。通过直销及经销相结合的销售模式，公司既可以与下游知名品牌客户保持紧密联系，又能够充分利用经销商的销售及服务渠道，将产品推广至更多下游客户，增加产品的市场份额，拓宽产品销售的覆盖范围。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司主要从事集成电路产品的研发、设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类

（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业中的“集成电路设计”（代码：6520）。根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所处的集成电路设计行业属于鼓励类产业。

（2）行业基本特点

集成电路设计处于集成电路产业链的上游，负责芯片的开发设计。集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分，芯片设计水平对芯片产品的功能、性能和成本影响较大，因此芯片设计的能力是一个国家在芯片领域能力、地位的集中体现之一。经过十年“创芯”发展，国内集成电路产业呈现集聚态势，逐步形成以设计业为龙头，封装测试业为主体，制造业为重点的产业格局。在国内集成电路行业中，设计业始终是最具发展活力的领域，是我国集成电路产业发展的源头和驱动力量。根据中国半导体行业协会的报告，2023 年中国集成电路设计业销售额为 5,470.7 亿元，同比增长 6.1%，保持平稳增长态势。除了行业规模显著增长外，集成电路行业的产业结构也不断优化，附加值较高的设计环节销售额占集成电路行业总销售额的比例从 2016 年的 37.93% 上升到 2023 年的 44.56%，已成为集成电路产业链中比重最大的环节。

集成电路行业也是支撑国民经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展，如 2000 年国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2011 年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2017 年工信部颁布的《物联网“十三五”规划》，2020 年国务院颁布的《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，2021 年国家发改委发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等。2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》：瞄准集成电路、关键软件、人工智能等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力，增强关键技术创新能力，加快推动数字产业化。2023 年 12 月，国家发改委修订发布了新版《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，明确将“集成电路设计”等列为鼓励类发展的项目。2024 年 2 月，国务院印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，将积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单。中国的集成电路产业政策旨在通过一系列综合措施，从资金、技术、人才等多个方面给予全方位的支持，构建健康、可持续发展的集成电路生态系统。这些相关政策彰显出我国在面对复杂地缘政治环境和应对逐渐加剧的

贸易冲突背景下，解决国家经济发展和产业瓶颈问题的信心与决心，为我国集成电路产业持续健康发展提供了政策助力。不仅有助于提升国内半导体产业的整体竞争力，也为全球半导体行业的发展提供了重要支撑。

国际上，Skyworks、Qorvo 作为全球领先的射频前端企业，经营历史长，在收入规模、技术积累、市场地位、人才储备等方面竞争优势明显，同时通过资本运作与企业并购，在各个应用领域中均拥有较完整的产品线布局与很强的产品竞争力。在射频前端市场中，目前仍主要由 Skyworks、Qorvo 为代表的龙头厂商占据主导地位。

（3）主要技术门槛

集成电路设计行业技术门槛较高，Fabless 模式下，集成电路设计环节是企业经营最为核心的业务环节，是决定企业未来持续经营能力的关键要素。企业通过研发设计进行技术积累，形成了较高的研发及技术壁垒，构建了企业的核心竞争优势。

集成电路设计行业技术水平呈现出专业性强、难度高、技术迭代速度快、与下游应用领域紧密配合等特点，各个细分领域之间均存在较高的技术壁垒，行业内的新进入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡，中小企业一般选择某一细分领域参与市场竞争，仅有少数国际巨头参与多领域竞争。

（2）. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在 Wi-Fi 通信领域，行业内主要企业仍以境外厂商为主，Skyworks、Qorvo 占据半数以上市场份额，立积电子市场份额位居行业第三。在境内射频前端厂商中，公司系 Wi-Fi 领域芯片国产化主要参与者，根据能够公开获取的资料，公司 Wi-Fi FEM 销售规模处于境内厂商中较为领先的地位，但相比于境外领先厂商，销售规模相对较低，仍处于追赶地位。

（3）. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的射频前端行业最主要的下游应用领域为无线网络设备行业，使用 Wi-Fi 通信技术实现网络连接。因此整个行业的发展和趋势与 Wi-Fi 通信技术的发展情况息息相关。

高通、联发科、博通等业界巨头纷纷推出了各自的 Wi-Fi 7 无线连接解决方案，标志着无线通信技术的新一轮革命已经到来，同时射频前端芯片平均用量及单颗产品价格都有所提升。新的协议也对射频前端芯片厂商设置了更高的技术准入门槛，芯片设计难度更高，想要在技术壁垒较高的 Wi-Fi 射频前端领域布局，只有推出更高功率、更高线性度、更低功耗、性能卓越、质量稳

定的产品，才能在市场竞争中与国际领先厂商较量。

Wi-Fi 由电气和电子工程师协会(IEEE)开发，该组织负责制定 Wi-Fi 标准。IEEE 802.11be，被称为极高吞吐量（EHT），是 IEEE 802.11 标准的下一个修订版，将被指定为 Wi-Fi 7。作为最新一代 Wi-Fi 技术标准，它集合了 320MHz 频宽、4096-QAM、增强 OFDMA、MLO 等技术，最高理论速率可以达到 46Gbps，是 Wi-Fi 6 的 4 倍以上。Wi-Fi 7 的时延相比前代也有明显下降，可以达到 5ms。2023 年 11 月 28 日国家无线电办公室印发了《关于采用 IEEE 802.11be 技术标准的无线局域网设备新增技术要求及检测方法的通知》，这意味着中国正式出台 Wi-Fi 7 的认证标准；另一方面国际 Wi-Fi 联盟组织（WFA）于 2024 年 1 月 8 日，正式宣布推出 Wi-Fi CERTIFIED 7 认证计划。Wi-Fi 7 新性能提升重点在 Wi-Fi 6E 的基础上，320MHz 超宽频段（需符合各国频谱政策），4096-QAM 高阶调制技术多资源单元分配（Multi-RU），多链路聚合（MLO, Multi-Link Operation），增强型 MU-MIMO（支持 16 条空间流），协同多 AP 传输（如 Coordinated Beamforming）。

目前市场上已经有越来越多可以支持 Wi-Fi 7 的新设备。下一代标准 IEEE 802.11bn（UHR, Ultra High Reliability）正在开发中，该标准聚焦工业物联网与 XR 场景的超高可靠性通信，极有可能被 Wi-Fi 联盟正式命名为“Wi-Fi 8”。

公司作为一家专注于 Wi-Fi 射频前端芯片研发的公司，成功地将自研非线性射频前端芯片应用于博通、高通的 Wi-Fi 7 平台参考设计中，并在配合联发科（MTK）Wi-Fi 7 新平台上也取得了突破，射频前端芯片获得了 MTK 器件平台的 DRL 资质认证。当今市场 Wi-Fi 7 作为一个新兴产业标准出现在用户的面前。Wi-Fi 新技术将赋能新产业，例如 8K A/V 流媒体、AR/VR、云游戏、全息交互式应用、工业物联网和工业 4.0、远程诊断和远程手术等应用领域，Wi-Fi 新技术将从前的“不可能”变为“可能”。

2023 年 5 月，工业和信息化部、教育部、公安部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，进一步提出提升电信基础设施共建共享的要求。固定宽带接入网逐渐告别 GPON 时代，当前基于 10G PON 的千兆宽带已经成为主流，开始向 50G PON 平滑演进，接入速率将向万兆升级，网络延时将进一步缩短，极大提高网络可靠性和稳定性，进一步满足精密自动化控制、远程医疗等高可靠场景需要。

一时间，各知名品牌厂商纷纷推出新款 Wi-Fi 7 路由器或推送 Wi-Fi 7 支持固件，而手机厂商也在给自家设备陆续 OTA（空中下载技术）以增加对 Wi-Fi 7 网络的支持。公司通过与国际知名主芯片厂商们合作，进行技术对接，验证并被纳入其无线接入平台的参考设计，商业模式上也发生了质的转变。从过去作为国际厂商替代的国产芯片，转变为主平台官方认证厂商与性能推荐型

号。在这一背景下，公司的产品受到了小米、中兴通讯、TP-LINK 等国内知名终端设备厂商的青睐，成功应用于这些厂商最新的无线路由器和网关设备中，为用户提供高速、稳定的无线连接。2024 年，公司的可线性化射频前端芯片成功进入法国知名电信运营商 Free，在 Free 发布的 Wi-Fi 7 网关设备 Freebox Ultra 中，与高通 Wi-Fi 7 平台结合，完成大规模量产出货。这一合作标志着公司迈向国际市场的脚步坚实有力。

展望未来，随着无线通信技术与协议的不断发展，Wi-Fi 技术仍将继续保持其在无线通信领域的重要地位。公司将继续深化研发，加强技术创新，不断拓展国内外市场，为终端客户以及电信运营商提供更加先进、高效、可靠的射频前端芯片解决方案，实现公司的长远发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	1,651,985,004.40	1,706,985,461.01	-3.22	1,117,022,453.55
归属于上市公司股东的净资产	1,509,538,738.81	1,614,862,803.35	-6.52	1,005,734,955.89
营业收入	522,786,449.10	414,960,534.13	25.98	419,755,928.40
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	522,786,449.10	414,960,534.13	25.98	419,755,928.40
归属于上市公司股东的净利润	-76,127,407.96	9,921,406.66	-867.30	20,455,620.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,198,105.84	1,882,295.70	-5,210.68	10,104,386.95
经营活动产生的现金流量净额	-169,442,261.02	-982,316.66	不适用	108,097,859.81
加权平均净资产收益率（%）	-4.83	0.94	减少5.77个百分点	2.06
基本每股收益（元/股）	-0.1794	0.0271	-761.99	0.0567
稀释每股收益（元/股）	-0.1794	0.0271	-761.99	0.0567
研发投入占营业收入的比例（%）	20.59	15.17	增加5.42个百分点	13.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	单位：元 币种：人民币			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	82,267,476.97	142,238,922.37	153,073,386.94	145,206,662.82
归属于上市公司股东的净利润	-24,069,746.72	6,159,328.51	-15,954,205.51	-42,262,784.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,455,714.60	3,926,183.94	-17,174,531.94	-55,494,043.24
经营活动产生的现金流量净额	-31,273,615.95	-80,946,478.77	-42,374,132.32	-14,848,033.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)				11,426			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				11,271			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）				0			
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）				0			
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
彭宇红	0	39,546,541	9.32	39,546,541	无	0	境内自然人
赵奂	0	33,870,213	7.98	33,870,213	无	0	境内自然人
上海乾晓芯企业管理中心（有限合伙）	0	24,418,858	5.75	24,418,858	无	0	其他
潘斌	0	23,517,126	5.54	0	无	0	境内自然人
东方华宇资本管理有限公司－嘉兴鑫仍创业投资合伙企业（有限合伙）	-1,418,103	14,697,839	3.46	0	无	0	其他

盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）	0	12,752,072	3.00	0	无	0	其他
姚冲	-4,244,800	11,835,910	2.79	0	无	0	境内自然人
英特尔产品（成都）有限公司	-1,608,413	11,084,917	2.61	0	无	0	境内非国有法人
胡思郑	0	10,322,382	2.43	0	无	0	境内自然人
上海觅芯企业管理中心（有限合伙）	0	10,232,791	2.41	10,232,791	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、彭宇红、赵免为一致行动人； 2、上海乾晓芯、上海觅芯为公司员工持股平台，两家企业的执行事务合伙人均为上海萌晓芯，彭宇红与赵免各持有上海萌晓芯 50%股权。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

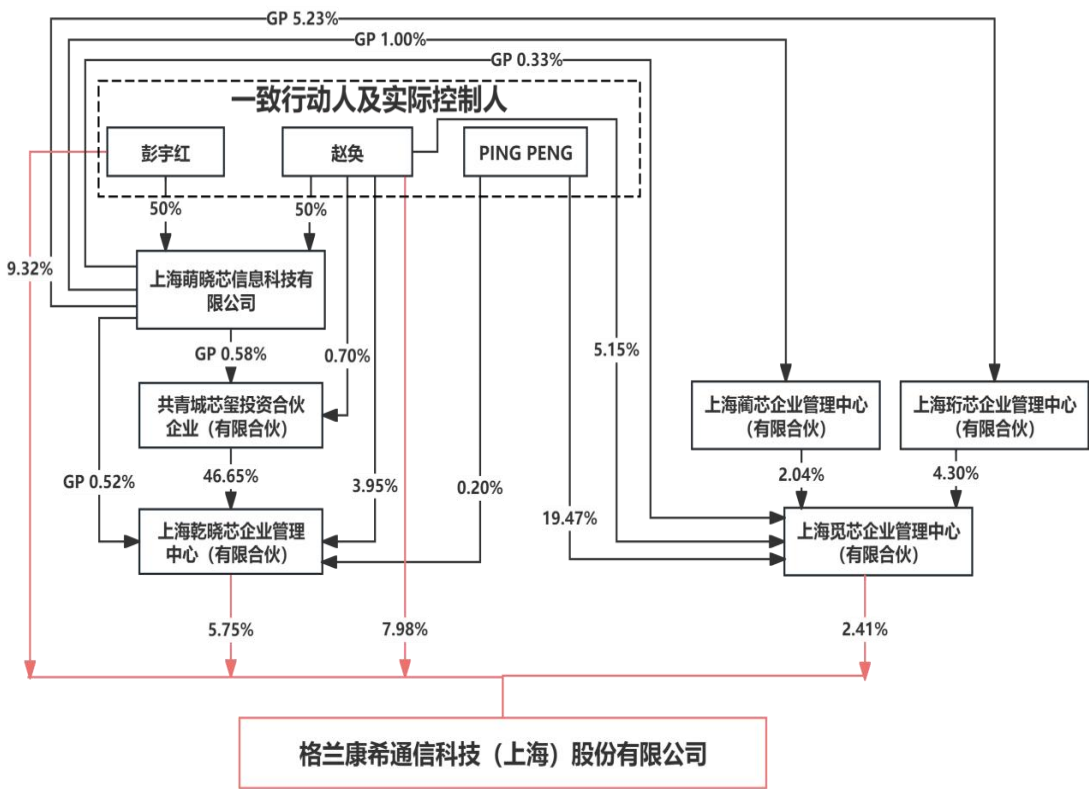
☐适用 ☒不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5、公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见以下内容：

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用